

粤芯半导体技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2026 年 10 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：粤芯半导体
- 2、股票代码：301660
- 3、首次公开发行后总股本：287,823.7397 万股（超额配售选择权行使前）；
295,513.3397 万股（超额配售选择权全额行使后）

4、首次公开发行股票数量：51,264.6000 万股（超额配售选择权行使前）；58,954.2000 万股（超额配售选择权全额行使后），本次公开发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为 287,823.7397 万股（超额配售选择权行使前）、295,513.3397 万股（超额配售选择权全额行使后），其中，无限售条件的流通股数量为 24,378.4639 万股，占发行后总股本的比例为 8.47%（超额配售选择权行使前）、8.25%（超额配售选择权全额行使后），公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为 12.01 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（四）发行市销率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 73.18 倍。

截至2026年9月18日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日 股票收盘价 (元/股)	T-4日 市值 (亿元)	2025年营业收入 (亿元)	对应市销率 (倍)
688981.SH	中芯国际	122.00	10,445.96	673.23	15.52
688347.SH	华虹宏力	234.00	4,512.68	172.91	26.10
688469.SH	芯联集成-U	8.72	730.97	81.80	8.94
688249.SH	晶合集成	36.75	821.28	108.85	7.54
688172.SH	燕东微	46.91	669.70	18.33	36.53
平均值（剔除极值）					14.52

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日）。

注 1：市销率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：市销率平均值计算剔除了极值（燕东微）。

本次发行价格为 12.01 元/股，对应的市销率为：

1、11.00 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

2、13.39 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本（超额配售选择权行使前）计算）；

3、13.74 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本（超额配售选择权全额行使后）计算）；

本次发行价格 12.01 元/股对应的发行人 2025 年未行使超额配售选择权时的摊薄后静态市销率为 13.39 倍，若全额行使超额配售选择权，则摊薄后静态市销率为 13.74 倍，低于可比上市公司 2025 静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行定价合理性说明如下：

与行业内其他公司相比，粤芯半导体在以下方面存在一定优势：

1、平台优势：“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体的产业布局

公司主要从事集成电路制造环节中的 12 英寸晶圆代工业务，具备集成电路、功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力，涵盖 MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台。公司成立以来，紧密贴合模

拟芯片行业品类多样化的产品特点，持续丰富自身产品组合，目前已具备较完整的成熟节点工艺制程，可为客户提供 180-55nm 等多个制程节点的特色晶圆代工服务，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

在技术创新方面，公司于 2024 年底成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术平台。截至本上市公告书提示性公告签署日，公司的硅光工艺技术平台累计投片量已超过 7,000 片；根据 Frost & Sullivan 数据，截至 2026 年 4 月末，公司是中国大陆唯一具备 12 英寸硅光晶圆大规模量产能力的企业。公司的硅光产品涵盖 400G、800G 及 1.6T 高速可插拔硅光光模块应用，与国际领先水平相当。同时，公司与业界先进水平保持同步，开展近封装光学（NPO）的工艺制造技术研发，目前正在导入 3.2T NPO 产品。未来，公司将进一步开展 65nm 硅光及光电融合工艺的研发和量产，实现从可插拔光模块向近封装光学（NPO）、光电共封装（CPO）的演进，以满足市场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体代工服务的集成电路制造企业。

2、模式优势：打造“终端、设计与制造”的协同优化模式

晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节，是半导体制造产业的核心构成。标准化工艺的晶圆代工模式在数字芯片等领域具备显著的效率和成本优势，但对模拟芯片并非最优。其主要原因在于模拟芯片的性能（如低失真、高信噪比、可靠性与稳定性）更依赖于工艺创新与器件优化，而非仅通过制程尺寸缩减，需通过特色工艺与设计的深度融合实现。

公司坚持特色工艺路线，基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀，能够以高质量的标准，开发具有市场竞争力的工艺技术平台。同时，公司深度协同芯片设计公司及终端客户，推动终端、设计与制造协同优化的创新模式，共同探讨工艺制造与设计优化的解决方案，积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求，增加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。该合作模式增强了客户粘性，提升了公司的品牌影响力，奠定了公司未来持续快速发展的基础，是公司市场竞争优势的重要体现。

3、区位优势：践行“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路

粤港澳大湾区是全国乃至全球电子产业终端厂商最集中的区域之一，汇聚智能移动终端、新一代电子信息、新能源汽车、智能机器人、超高清视频显示、智能家电等万亿级产业集群，拥有从芯片设计、终端制造到市场应用的完备产业链基础。随着全球产业链的重构，中国厂商在智能移动终端、汽车电子、智能机器人、人工智能等高科技领域的重要性逐渐凸显，终端定义需求，终端牵引设计，已经逐渐成为产业协同推动创新技术商业落地的高效转化模式。

公司发挥贴近终端客户，掌握市场动态，积极构建生态的区位优势，通过深度协同区域内的上游集成电路设计厂商与下游终端应用企业，打造紧密的产业联盟，打通从设计到制造、再到应用的关键环节，以高效协同、快速响应的服务模式，灵活的经营策略和充分的产能支持，满足客户的多样化需求，激发产业的创新活力。

公司与总部位于大湾区的全球指纹识别芯片龙头企业紧密合作，成功攻克硅基超声波指纹识别芯片的制造技术难题，实现了国内该领域的技术突破，打破境外厂商在该领域长期垄断地位，使公司成为国内少数具备硅基超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。目前，该创新方案已成功导入 VIVO、OPPO 等多家扎根大湾区的知名手机品牌。

4、人才团队优势：国际化专业人才梯队与市场化管理机制，打造竞争活力

公司的技术及管理专家来自全球各地，具有多家国际知名半导体企业的任职经历，核心管理团队更拥有 20 余年的深厚行业积淀。公司具备强大的企业管理及技术研发能力，并已构建起合理的人才梯队。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总数达 1,943 人，硕士及以上学历人员占比为 20.48%，拥有 3 年及以上半导体行业经验者超过 60%。

在治理结构方面，公司拥有多元化和专业化的股东背景、完善的公司治理结构、市场化的经营管理机制，赋予了公司高度的灵活性，使其能够快速响应市场需求变化，精准选择产品和发展路径，高效制定商业决策。此外，公司已对核心骨干员工实施了股权激励计划，这不仅显著提高了核心团队的稳定性，更有效激发了员工的创新创造活力，为公司人才优势的巩固与长期可持续发展奠定了坚实

基础。

5、质量管理体系优势：构筑完备的认证体系，保障市场口碑

公司已通过 ISO 9001、ISO 50001、ISO 14001、ISO 45001 等国际质量管理体系认证；瞄准车规产品产线质量控制要求，建立完善的生产参数控制及质量控制系统、失效模式与影响分析机制（FMEA），并已通过车规生产线质量管理体系 IATF 16949 认证；按照国际权威的德国汽车工业联合会过程审核标准 VDA6.3 要求，系统性构建面向车规级芯片的全生命周期质量管理体系。

一系列完备的质量管理体系和严格的质量控制标准，提升了公司生产经营的规范化水平，保障了公司晶圆代工服务的产品良率和交付质量，有助于公司建立和维护良好的市场口碑和品牌形象，获得客户的高度认可。

6、客户优势：携手境内外芯片设计龙头企业，夯实客户基础

公司自成立以来一直致力于客户资源的拓展与积累，主要客户涵盖境内外多家半导体行业上市公司和龙头企业，凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力，获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司近 40 家，包括全球领先的芯片设计公司 & 多家细分领域行业龙头企业：全球第一大指纹识别芯片设计公司、全球第一大电子标签芯片设计公司、全球出货量第二大的图像传感器芯片设计公司、全球前三大独立智能手机芯片设计公司中的两家、中国第一大 MCU 芯片设计公司，以及多家显示驱动芯片、电源管理芯片及功率器件上市公司。在公司重点聚焦的模拟芯片领域，国内前十大模拟芯片上市公司合作覆盖率 80%。

基于对公司研发能力、技术平台、产能支持、产品品质、服务配合度的认可，行业龙头企业与公司建立并维持了良好的合作关系。坚实的客户基础，推动公司产品平台的技术迭代和技术积累，不断提升经营业绩和盈利能力。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，

不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，另需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（六）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，产生效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人：粤芯半导体技术股份有限公司

法定代表人：陈谨

联系地址：广州市黄埔区凤凰五路 28 号

联系人：董事会办公室

电话：020-62322134

（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

联系地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：资本市场部

电话：020-66336596、020-66336597

（三）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：资本市场部

电话：021-38032666

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2026 年 10 月 12 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2026年10月12日